

证券代码：300689

证券简称：澄天伟业

编号：2026-006

深圳市澄天伟业科技股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他
参与单位名称/人员姓名	国联民生、世纪致远、望正资产、中盛晨嘉
时间	2026 年 8 月 12 日
地点	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 34 楼公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事：宋嘉斌 董事会秘书、财务总监：蒋伟红 证券事务代表：陈远紫
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司介绍基本情况和发展历程。 二、公司与调研机构的互动交流。 公司与调研机构方互动交流的主要内容如下： Q1、公司液冷业务目前的产品线布局如何？各产品线的进展和交付节奏是怎样的？ 答：公司液冷业务主要产品包括液冷板、不锈钢波纹管、Manifold 等核心部件，公司深度参与客户产品共同开发，产品线主要分为三条：在高性能GPU液冷模组方面，公司主要为客户提供GPU液冷模组及机柜内部歧管等核心部件，目前该产品线将跟随客户量产节奏推进，当前能见度较前期有所提升。在上一代主力产品组件方面已开始进入产能排期阶段。在CPU产品线方面，目前处于产品预研阶段，公司正与客户共同进行工艺开发，围绕服务器及超节点场景开展相关液冷方案技术准备。 公司液冷业务的整体放量节奏与中国台湾客户的交付排期高度关联。公司核心客户在头部半导体公司中占有一定份额，公司作为其核心供

应商，有望受益于其液冷模组的放量。根据目前与核心客户的沟通及行业市场信息，公司液冷业务预计在下半年逐步起量。公司实际收入规模受客户最终订单量、产品价格、量产节奏等多重因素影响，具有一定不确定性，如有达到披露标准的相关事项，公司会及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

Q2、公司液冷业务的产能规划及扩产节奏如何？

答：公司液冷业务生产基地位于广东惠州，目前已通过自有资金完成首期建设。惠州基地共有四栋厂房，首期已启用两栋，二期厂房已开始装修，预计快的话今年四季度可完成设备安装调试，新增产能主要用于配合核心客户订单放量需求。公司整体产能建设与客户放量节奏保持匹配，后续根据市场需求及客户放量节奏审慎规划产能建设，逐步提升规模化交付能力，匹配全球算力液冷增量需求。

Q3、公司液冷业务与台湾客户的合作渊源及商务关系是怎样的？

答：公司与中国台湾客户的合作关系可追溯至行业需求兴起之初。当时客户提及头部半导体公司有液冷散热需求，公司基于自身在精密金属加工领域的技术积累，迅速组建团队进行布局。公司通过自有资金在惠州建立研发与量产基地，组建了涵盖产品设计、工艺验证、客户对接、批量生产的完整团队。公司在产品质量、交付能力及工艺水平方面获得了客户较高认可。公司不仅提供液冷零部件加工服务，更深度参与客户产品共同开发，从新一代高性能计算平台项目开始持续进行产品迭代开发。公司以其整体工艺导向参与产品研发，是客户冷板、管路、歧管、模组等核心部件供应商。

Q4、公司液冷业务的竞争格局和竞争优势如何？

答：当前液冷赛道参与者持续增多，行业准入壁垒显著：客户验证周期长、精密制造工艺严苛、产品对钎焊密封性、流道一致性、生产洁净度、批次测试稳定性要求极高，工艺爬坡周期长，规模化交付能力需要较长时间沉淀。公司竞争优势主要体现在三个方面：

第一，技术能力方面，公司依托半导体封装多年工艺积累，在高导热

	金属材料、蚀刻、电镀、钎焊等工艺方面具备长期技术沉淀，形成了从材料到结构件再到模组组件的全链条能力。 第二，客户关系方面，公司与中国台湾客户建立了深度绑定的合作关系，双方在技术理解、工艺储备与迭代节奏上保持同步。公司作为重要供应商，在客户供应商体系中占据重要位置，这种深度合作关系为公司业务的持续性和稳定性提供了有力保障。 第三，制造能力方面，公司具备从机加工、焊接、组装到清洗检测的全流程制造能力，尤其在后端清洗、检测等环节投入较多资源，可面向终端客户提供整套系统级解决方案。区别于纯前段加工厂商，后端能力有助于获取更全面的行业洞察，可面向国内终端客户提供完整方案。 Q5、公司在国内市场液冷业务的拓展情况如何？ 答：在国内市场，公司已积极拓展与头部服务器厂商、互联网企业等的合作。目前公司已向国内多家头部算力基础设施厂商送样，随着国产ASIC芯片算力持续提升，国内市场液冷散热需求同样强劲，公司将依托在海外市场积累的技术能力和产品经验，探索液冷散热解决方案在国产ASIC生态中的应用，逐步拓展国内市场份额。 Q6、MLCP（微通道封装盖板）技术的研发进展如何？ 答：MLCP（微通道封装盖板）是下一代芯片级散热技术路线，将微米级冷却通道集成至芯片封装内部，大幅缩短冷却液与芯片热源距离，适配先进封装高功耗算力芯片。MLCP技术工艺壁垒高，公司依托封装材料工艺、蚀刻、钎焊工艺等积累具备天然协同优势。 MLCP的技术方案目前仍处于与客户联合研发和验证阶段，工艺路径仍在迭代优化，基于当前行业技术成熟度判断，短期内仍以冷板式液冷产品的规模化交付为业务重心。公司对MLCP技术路线保持密切跟踪，产品竞争力本质体现在综合制造能力与工艺深耕积淀，MLCP的产业化节奏将视终端芯片方案及封装环节技术突破情况而定。 Q7、公司半导体封装材料业务的现状及扩产规划如何？
--	--

	答：公司半导体封装材料业务主要涉及MOSFET、IGBT、SiC等功率模块的封装材料供应。主要客户包括国内知名的功率半导体封装企业。近年来该业务保持强劲增长态势，后续将根据市场需求及经营情况审慎扩大产能。半导体封装材料业务扩产相对灵活，关键设备采购周期约为三个月，但客户验证周期较长，新产品验证通常需要数月时间。公司将根据客户产品节奏审慎推进产能扩张，避免盲目资本开支。 Q8、智能卡业务的现状和展望如何？ 答：智能卡业务已进入成熟期，预计将保持平稳发展态势。该业务国外市场占比较高、现金流稳定。公司对该业务目前暂无新的扩产计划，未来将主要维持现有规模，并通过向超级SIM卡等服务方向升级以提升盈利水平。整体收入体量预计保持现有水平。 Q9、如何看待液冷业务未来的业绩贡献及盈利水平？ 答：目前公司液冷业务收入占营收比重较低，早期收入主要来自送样、小批量及工程验证，该业务已进入从验证导入向规模化交付过渡的关键阶段。液冷业务的业绩贡献将伴随客户认证、订单落地和产能爬坡逐步体现，当前能见度较前期有所提升。公司液冷业务有望成为未来业绩的重要增长点。 液冷产线从导入到稳定量产仍需经历良率和产能利用率提升过程。毛利率和净利率会受到产品结构、产能利用率、良率、设备折旧及客户价格等因素影响，阶段性波动较大。未来随着客户订单持续放量、产能利用率提升及规模化效应显现，公司液冷业务的收入规模和盈利水平有望持续提升，成为驱动公司业绩增长的重要动力。公司将紧跟客户节奏推进交付，具体收入和利润贡献将结合终端需求、供应份额、产品价格、量产进度及成本控制体现。
风险提示	公司提醒新业务新产品开发过程中存在一定的技术风险、市场风险和应用验证周期风险，上述内容如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关信息，不视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺与保证，公司将严格按照有关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

附件清单 (如有)	无
日期	2026-8-12